

关于“**2022 半导体封装技术展** **(IC PACKAGING FAIR 2022)**”延期举办的公告

尊敬的展商、观众、合作伙伴、媒体朋友：

针对当前深圳及国内部分地区依然复杂的疫情防控形势，为响应政府对疫情防控工作的总体部署，降低疫情传播风险，同时为切实保障展商、观众与工作人员的健康安全利益，全面达成展会的预期效果，经主办方审慎评估决定，原定于**2022年10月12-14日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举办的“2022 半导体封装技术展 (IC PACKAGING FAIR 2022) ”**将延期至**2022年11月30日-12月2日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举办。**

感谢您对**IC PACKAGING FAIR 2022 半导体封装技术展**的支持与关注，因展会延期给您带来的不便，我们深表歉意。我们将持续关注疫情的发展，密切与相关部门沟通，全力做好展会延期的各项工作。相信在更充足的筹备时间里，**IC PACKAGING FAIR 2022 半导体封装技术展**将继续与同期举办的**NEPCON ASIA 2022 亚洲电子生产设备暨微电子工业展**、**S-FACTORY EXPO 2022 智能工厂及自动化技术展**、**ES SHOW 2022 深圳电子元器件及物料采购展**、**AUTOMOTIVE WORLD CHINA 2022 中国汽车工业技术展**、**C-TOUCH & DISPLAY SHENZHEN 2022 深圳国际全触与显示展**、**COMMERCIAL DISPLAY 2022 深圳商用显示技术展**、**FILM & TAPE EXPO 2022 深圳国际薄膜与胶带展**、**AMTS & AHTE South China 2022** 等展览会联动，以“跨界+芯+智造”为创新理念，通过展示半导体封测制程设备、PCBA 制程设备、智能工厂软件等创新产品，为下游半导体封测厂商、涉

足 SIP 工艺的头部 EMS 电子制造服务商提供更多行业最新技术及解决方案。我们相信更强大的参展阵容、更精彩的现场活动将助力电子制造行业同仁达成卓有成效的商贸目的。

秋后时节，硕果人间！再次感谢展商、观众与合作伙伴及媒体对 **IC PACKAGING FAIR 2022 半导体封装技术展** 的支持与鼓励。如您需要了解更多信息，敬请与我们联络。期待与您十一月在深圳国际会展中心（宝安新馆）相见！祝愿您和家人平安健康！

展会主办方：

中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会



附：主办方联络信息

展商请联络：

徐乙冰 先生，电话：021-22317051，邮箱：bruce.xu@rxglobal.com

程安然 女士，电话：010-68200642，邮箱：chenganran@ccpitecc.com

观众请联络：

孙梅 女士，电话：400 650 5611，邮箱：mei.sun@rxglobal.com

欲了解更多展会信息，请登录展会官方网站 www.s-factoryexpo.com 或关注展会官方微信公众号。



S-FACTORY EXPO

官方微信号